（上接81版）

账龄	2025年末余额	2024年末余额	变动金额
1年以内	11,740.67	7,413.40	4,327.27
1-2年	949.66	1,084.03	-134.36
2-3年	3.13		3.13
小计	12,693.46	8,497.43	4,196.03
减:坏账准备	778.53	587.48	191.05
合计	11,914.93	7,909.95	4,004.98

由上表可见，2025年末应收账款账面余额为12,693.46万元，较2024年末账面余额8,497.43万元增加4,196.03万元，主要系2025年收入较2024年大幅增加导致应收账款增加，此外本期因将无锡众享纳入合并范围内导致应收账款增加1,150.48万元。

（二）应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的主要欠款方情况

1、应收账款主要欠款方情况

单位：万元

客户	形成时间	交易内容	2025年末	
			期末余额	余额占比
宁波群芯微电子股份有限公司	2025年度	隔离固态继电器；平面MOSFET	1,319.46	10.39%
无湖华芯微电子有限公司	2025年度	沟槽MOSFET	1,126.93	8.88%
客户H	2024-2025年度	电源管理	1,076.92	8.48%
客户I	2025年度	电机驱动	1,063.66	8.38%
客户D1	2024-2025年度	电源管理、电机驱动	863.03	6.80%
客户B	2025年度	电源管理	694.42	5.47%
瑞森半导体科技（广东）有限公司	2025年度	FR MOSFET、平面MOSFET；电源管理	569.31	4.49%
四川升华电源科技有限公司	2025年度	电源管理	357.58	2.82%
客户E	2025年度	隔离固态继电器	325.68	2.57%
晶芝半导体有限公司	2025年度	FR MOSFET	287.82	2.27%
小计			7,837.80	61.75%
应收账款余额			12,693.46	

注1：上表列示了余额前十大客户；

注2：上述客户同时为历年前十大客户，交易背景详见前文“二、关于主要客户及供应商”之“一、（二）近三年前十大客户合作历史及变动情况”，下表同。

2、应收账款账龄在1年以上情况

单位：万元

客户	形成时间	交易内容	期末余额	账龄			期末坏账准备余额
				1年以内	1-2年	2-3年	
客户H	2024-2025年度	电源管理	1,076.92	654.96	421.96		117.14
客户D1	2024-2025年度	电源管理、电机驱动	863.03	611.26	251.77		80.92
盛廷微电子（无锡）有限公司	2024年度	超结MOSFET	153.00		153.00		30.60
合计			2,092.95	1,266.21	826.74		228.66

注：上表列示了应收账款账龄在1年以上的主要客户。

3、应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的主要欠款方交易内容、信用政策及逾期情况

客户	交易内容	信用政策		逾期情况
		2025年度	2024年度	
宁波群芯微电子股份有限公司	隔离固态继电器；平面MOSFET	20号对账，2个月月底收款	20号对账，2个月月底收款	客户订单起量过程中，回款有逾期
无湖华芯微电子有限公司	沟槽MOSFET	25号对账，3个月月底收款	25号对账，3个月月底收款	回款有逾期，客户下游回款不佳，从过往合作历史评估，回款风险可控
客户H	电源管理	月底对账，1个月月底收款	月底对账，1个月月底收款	回款有逾期，客户下游回款不佳
客户I	电机驱动	25号对账，5个月后15号收款		回款有逾期，终端客户需求变动导致客户下游回款不佳，持续督促其有序回款
客户D1	电源管理、电机驱动	25号对账，1年后月底收款	月底对账，6个月月底收款	回款有逾期，系为高可靠领域客户，回款周期长
客户B	电源管理	月底对账，4个月月底收款	月底对账，2个月月底收款	回款有逾期，系为高可靠领域客户，回款周期长
瑞森半导体科技（广东）有限公司	FR MOSFET、平面MOSFET；电源管理	25号对账，6个月月底收款	25号对账，3个月后月底付款	回款有逾期，客户下游回款不佳
四川升华电源科技有限公司	电源管理	月底对账，6个月月底收款	月底对账，1个月月底收款	回款有逾期，系为高可靠领域客户，其下游客户也为高可靠领域，回款周期长
客户E	隔离固态继电器	月底对账，9个月后底收款	月底对账，3个月月底收款	无
晶芝半导体有限公司	FR MOSFET	25号对账，1个月月底收款	25号对账，1个月月底收款	无
盛廷微电子（无锡）有限公司	超结MOSFET	20号对账，2个月后15号收款	20号对账，2个月月底收款	期后已全部回款

公司主要应收账款账龄均在1年以内，部分客户出现逾期系客户自身审批流程较长、下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款。报告期内逾期客户主要为高可靠领域客户，该部分客户资信情况良好，信誉较高，与公司长期持续合作，且款项陆续收回，不存在客户财务恶化的迹象，大额应收账款无法收回的风险较小。公司结合客户性质和过往合作历史评估，本期对部分长期合作的优质客户（包括高可靠及其他重点客户）优化了结算周期。

客户D1为高可靠领域客户，其自身审批流程较长、自身的资金规划等因素导致货款逾期时间较长，但客户资信情况良好，信誉较高，与公司长期持续合作，不存在客户财务恶化的迹象，大额应收账款无法收回的风险较小。

客户H、盛廷微电子（无锡）有限公司因下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款，从过往合作历史评估，回款风险可控。

4、2025年末应收账款较2024年变动情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动
营业收入	25,456.78	13,013.44	95.62%
应收账款	12,693.46	8,497.43	49.38%
应收账款与营收比重	49.86%	65.30%	-23.64%

2025年末应收账款账面余额为12,693.46万元，较2024年末账面余额8,497.43万元增加4,196.03万元，主要系2025年收入较2024年大幅增加导致应收账款增加，应收账款增长幅度远小于营业收入增加幅度，期末应收账款占当期营业收入比重由上期的65.3%下降至本期的49.86%。此外本期因将无锡众享纳入合并范围内导致应收账款增加1,150.48万元。

综上，2025年收入较2024年大幅增加，且无锡众享于本期纳入合并范围导致2025年末应收账款余额较2024年度大幅增加，具有合理性。

（三）坏账准备计提是充分的

公司2025年末应收账款账龄情况主要为1年以内，占比92.49%，应收账款账龄结构较好，应收账款账龄及坏账准备具体情况如下：

单位：万元

账龄	2025年末				2024年末			
	账面余额	余额占比（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	余额占比（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,740.67	92.49	587.03	5.00	7,413.40	87.24	370.67	5.00
1-2年	949.66	7.48	189.93	20.00	1,084.03	12.76	216.81	20.00
2-3年	3.13	0.02	1.56	50.00				
合计	12,693.46	100.00	778.53	6.13	8,497.43	100.00	587.48	6.91

由上表可以看出，公司一年以上的应收账款占比呈下降趋势，公司近几年未发生应收账款无法收回的情形，2025年末应收账款预期能够逐步回收，截至目前未出现无法收回的情形。

从公司应收账款信用损失模型角度来看，公司根据账龄和预期信用损失率计提信用减值损失，公司预期信用损失率与同行业可比公司相比不存在重大差异，具体情况如下：

公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
士兰微	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
华微电子	1.38%	21.51%	54.26%	85.41%	100.00%	100.00%
新洁能	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
东微半导	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
平均值	4.10%	15.38%	41.07%	96.35%	100.00%	100.00%
公司	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

综上，公司应收账款账龄状况较好，未出现应收账款无法收回的情形；公司账龄组合计提比率与同行业可比公司不存在重大差异，公司按照账龄组合于2025年末已计提应收账款信用减值准备778.53万元，综合计提比例6.13%，应收账款信用减值损失计提具有充分性。

三、年审会计师核查意见

1、核查程序：

（1）获取票据台账、应收账款明细账，了解主要客户期末应收款形成的具体情况；

（2）选取主要客户执行函证程序、细节测试及替代程序，分析应收账款的余额、应收票据签收金额的合理性、真实性，2025年末应收账款余额的发函比例为92.01%，回函比例为84.03%，未回函的部分已执行了替代程序；

（3）对期末余额较大客户检查其信用政策，是否存在逾期，询问销售部门与管理层回款不佳或逾期的原因，应收账款的可收回性，拟采取的催款措施；查看期后收款情况，并评估其信用减值准备计提的充分性；

（4）获取应收账款及应收票据的信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性；

2、核查意见：

经核查，年审会计师认为：

（1）公司已列示应收票据相关信息，公司应收票据坏账计提具有充分性，商业承兑汇票坏账计提比例较上年大幅下降系商业承兑汇票还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末减少所致，具有合理性；

（2）公司已列示应收账款相关信息；公司应收账款增加主要系营业收入增加、并购无锡众享影响以及个别客户应收账款增加所致，部分客户信用政策变动具有合理性，部分客户因自身审批流程较长、下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款；根据过往合作历史评估，公司回款风险可控，公司应收账款坏账计提具有充分性。

四、持续督导机构核查意见

1、核查程序

（1）获取票据台账、应收账款明细账，了解主要客户期末应收款形成的具体情况；

（2）复核年审主要客户函证回函，分析应收账款的余额、应收票据签收金额的合理性、真实性；

（3）对期末余额较大客户检查其信用政策，是否存在逾期，询问销售部门与管理层回款不佳或逾期的原因，应收账款的可收回性，拟采取的催款措施；查看期后收款情况，并评估其信用减值准备计提的充分性；

（4）获取应收账款及应收票据的信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性。

二、核查意见

（1）公司已列示应收票据相关信息，公司应收票据坏账计提具有充分性，商业承兑汇票坏账计提比例较上年大幅下降系商业承兑汇票还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末减少所致，具有合理性；

（2）公司已列示应收账款相关信息；公司应收账款增加主要系营业收入增加、并购无锡众享影响以及个别客户应收账款增加所致，部分客户信用政策变动具有合理性，部分客户因自身审批流程较长、下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款；根据过往合作历史评估，公司回款风险可控。

四、关于其他应收款

年报显示，2025年末公司其他应收款期末余额1,689.28万元，较上年末增长362%。其中，1年以内其他应收款1,455.47万元，1年以上其他应收款322.72万元，保证金及押金为1,686.30万元。

请公司：（1）说明其他应收款较上年末大幅增长的原因，主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后回款情况；（2）说明押金及保证金的用途、对手方与公司的历史合作情况；（3）说明一年以上保证金的用途，相关减值计提是否充分。

公司回复：

一、说明其他应收款较上年末大幅增长的原因，主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后回款情况；

（一）其他应收款较上年末大幅增长的原因

公司近两年其他应收款情况如下：

单位：万元

款项性质	期末余额	期初余额	变动金额
保证金及押金	1,686.30	308.98	1,377.33
其他款项	91.89	75.97	15.92
小计	1,778.19	384.95	1,393.25
减:坏账准备	88.91	19.25	69.66
合计	1,689.28	365.70	1,323.58

由上表可见，2025年末其他应收款账面余额为1,778.19万元，较上期增加1,393.25万元，主要系本期向供应商支付保证金增加所致。

（二）主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后回款情况

2025年末，公司其他应收款中保证金及押金的主要构成如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	期末坏账准备	账龄	期后回款
无锡晶芯科技有限公司	保证金	650.00	32.50	1年以内450万，1-2年200万	
粤芯半导体技术股份有限公司	保证金	500.00	25.00	1年以内500万	
芯恩（青岛）集成电路有限公司	保证金	300.00	15.00	1年以内300万	
供应商Z1	保证金	150.00	7.50	1年以内100万，3-4年50万	100.00
迪克创新科技(苏州)有限公司	投标保证金	10.00	0.50	1年以内10万	
小计		1,610.00	80.50		100.00

2024年末，公司其他应收款中保证金及押金的主要构成如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	期末坏账准备	账龄	期后回款
无锡晶芯科技有限公司	保证金	200.00	10.00	1年以内200万	
供应商Z1	保证金	50.00	2.50	2-3年50万	
小计		250.00	12.50		

二、说明押金及保证金的用途、对手方与公司的历史合作情况

（一）押金及保证金的用途

2025年末其他应收款中保证金及押金较2024年大幅增加主要系向供应商无锡晶芯、粤芯半导体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致。晶圆代工厂本身属于重资产模式经营，一般会要求合作客户支付保证金，属于行业内常见经营模式。无锡晶芯、供应商Z1、粤芯半导体、青岛芯恩均为晶圆供应商。

无锡晶芯科技有限公司保证金本期增加450万元主要原因是获取供应商Z1产能额度的保证和付款周期的支持，该模式符合行业惯例。

粤芯半导体技术股份有限公司本期新增保证金500万元原因是为获取产能额度的保证，该模式符合行业惯例。

芯恩（青岛）集成电路有限公司本期新增保证金300万元原因是为获取产能额度的保证和付款周期的支持，该模式符合行业惯例。

供应商Z1新增的100万保证金为本期纳入合并范围的无锡众享向供应商Z1支付的保证金，原因是为获取约定的相应额度付款周期的支持，该模式符合行业惯例。

（二）对于方与公司的历史合作情况

1、供应商Z1

（1）公司与供应商Z1的交易背景及历史合作情况豁免披露

（2）无锡众享与供应商Z1的交易背景及历史合作情况

无锡众享基于产品与工艺平台的匹配性，根据自身产品的规格需求，选择了供应商Z1合适的工艺平台去完成晶圆流片环节，以确保双方在技术上的兼容性和可实现性，双方自2021年开始合作至今。

2、无锡晶芯科技有限公司的交易背景及历史合作情况豁免披露

3、粤芯半导体技术股份有限公司

粤芯半导体技术股份有限公司成立于2017年，注册资本236,559.14万元，是拥有国内12英寸功率器件晶圆代工厂的头部企业，主要从事SGT MOSFET工艺晶圆代工业务。公司自2025年与粤芯半导体建立合作，并主要委托其代工生产SGT MOSFET的晶圆。

4、芯恩（青岛）集成电路有限公司

芯恩（青岛）集成电路有限公司成立于2018年，注册资本1,006,720.7892万元，芯恩集成拥有8英寸晶圆、12英寸晶圆的生产线，主要从事晶圆生产代工业务。公司自2022年与芯恩集成建立合作，并主要委托其代工生产沟槽型MOSFET的晶圆。

三、说明一年以上保证金的用途，相关减值计提是否充分。

公司支付晶圆代工厂的保证金，通常在合作期间保持相对稳定，除因业务量变化导致新增或减少保证金情形。相关保证金在合作完成后或者定期进行退回或抵减货款，从历史数据来看，保证金的损失风险较小，公司按照在整个存续期间按照5%计提信用减值风险，同行业公司（Fabless模式芯片设计公司）中通常也是在存续期间一定比例计提或者不考虑减值。

公司名称	计提政策
必易微（688045.SH）	其他应收款分为三个组合计算预期信用损失，①款项性质组合②关联方组合③低风险组合，未按离具体计提比例；根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，保证金组合按照在整个存续期间按照0.5%计提信用减值风险
纳芯微（688052.SH）	其他应收款分为多个组合，根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，订单保证金组合按照在整个存续期间按照5%计提信用减值风险
南芯科技（688484.SH）	其他应收款分为多个组合，根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，其中不同保证金组合按照在整个存续期间按照1%或5%计提信用减值风险

综上比较，公司与保证金相关的减值计提是充分的。

四、年审会计师核查意见

1、核查程序：

（1）获取其他应收款明细账，了解主要客户期末其他应收款形成的具体情况；询问运营部门，了解公司向供应商支付大额保证金的原因；

（2）选取主要公司执行函证程序、细节测试，获取其他应收款构成的相关协议及交易单据，分析其他应收账款的余额合理性、真实性；

（3）获取其他应收款信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性。

2、核查意见：

经核查，年审会计师认为：（1）其他应收款增长主要系本期向供应商支付保证金增加；公司已披露主要的交易对手方、交易背景、账龄及期后回款情况；

（2）2025年末其他应收款中保证金及押金较2024年大幅增加主要系向供应商无锡晶芯、粤芯半导体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致；

（3）公司与保证金相关的减值计提是充分的。

五、持续督导机构核查意见

1、核查程序

（1）获取其他应收款明细账，了解主要客户期末其他应收款形成的具体情况；询问运营部门，了解公司向供应商支付大额保证金的原因；

（2）选取主要公司执行函证程序、细节测试，获取其他应收款构成的相关协议及交易单据，分析其他应收账款的余额合理性、真实性；

（3）获取其他应收款信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性；

2、核查意见

（1）其他应收款增长主要系本期向供应商支付保证金增加；公司已披露主要的交易对手方、交易背景、账龄及期后回款情况；

（2）2025年末其他应收款中保证金及押金较2024年大幅增加主要系向供应商无锡晶芯、粤芯半导体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致；

（3）公司与保证金相关的减值计提是充分的。

五、关于存货。

年报显示，2025年末公司存货余额2.39亿元，较上年末增加41.01%，已超过年度营业成本1.71亿元；存货跌价准备9,174.69万元，较上年末增加66.36%。其中，原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、合同履约成本账面余额分别为1,186.90万元、4,691.03万元、17,110.57万元、109.04万元、780.26万元，存货跌价准备分别为805.14万元、389.16万元、7,691.26万元、12.40万元、276.72万元。

请公司：（1）列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，结合下游市场需求、公司经营及备货策略等，说明存货大幅增加的原因及合理性；结合各类产品产销情况，说明在库存量较大情况下，仍大幅提高产量的原因及合理性；（2）结合存货跌价准备的计提政策、计算过程，说明存货跌价准备增幅较大的原因及合理性，库存商品、原材料计提大额减值的原因，存货跌价准备计提政策是否与前期一致；（3）对于库龄2年以上的存货，说明具体的存货类型、对应产品、形成时间、生产背景、是否有对应订单、长期未结转原因、历史产销量变动情况。

公司回复：

一、列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，结合下游市场需求、公司经营及备货策略等，说明存货大幅增加的原因及合理性；结合各类产品产销情况，说明在库存量较大情况下，仍大幅提高产量的原因及合理性；

（一）存货具体内容

单位：万元

项目	产品大类	明细分类	期末余额	库龄情况			期后结转情况（2026年一季度）
				1年以内金额	1-2年以内金额	2年以上金额	
原材料	功率器件	SiC MOSFET	746.96	-	10.97	736.00	-
		平面MOSFET	150.40	106.35	10.40	33.66	25.40
		其他	227.40	226.57	0.37	0.46	103.45
	功率IC	电源管理IC	62.14	42.44	11.55	8.16	52.14
在产品	功率器件	沟槽MOSFET	1.53	1.38	0.15	-	0.75
	功率IC	电源管理IC	17.74	16.21	1.53	-	10.98
库存商品	功率器件	平面MOSFET	3,631.34	1,726.33	566.65	1,338.36	681.04
		SiC MOSFET	2,663.95	731.22	663.33	1,269.40	29.21
		FR MOSFET	1,664.24	1,127.41	271.34	265.49	474.11
		沟槽MOSFET	1,453.85	1,203.35	40.73	209.77	296.89
		超结MOSFET	1,284.60	442.63	120.12	721.86	93.79
		屏蔽栅MOSFET	797.27	586.96	94.58	115.73	125.54
		其他	521.00	111.64	203.04	206.33	2.97
	功率IC	电源管理IC	2,712.80	2,002.55	361.29	348.96	285.52
		功率驱动IC	1,342.88	864.85	136.82	341.20	48.98
		隔离固态继电器	727.05	408.05	122.27	196.73	136.01
		其他	311.58	140.23	56.38	114.98	40.10
发出商品	功率器件		63.45	63.40	0.05	-	57.04
	功率IC		45.59	42.62	2.97	-	31.87
委托加工物资	功率器件	平面MOSFET	1,120.09	1,119.29	0.80	-	798.77
		FR MOSFET	909.29	907.18	2.10	-	500.23
		其他	612.01	604.66	5.27	2.08	567.79
	功率IC	电源管理IC	1,234.58	1,019.26	215.32	-	576.10
		功率驱动IC	423.28	335.72	87.56	-	225.41
		隔离固态继电器	365.29	317.21	48.08	-	230.25
		其他	26.51	18.49	8.02	-	7.23
合同履约成本	技术开发	技术开发	780.26	182.66	312.50	285.10	69.39
合计			23,897.07	14,348.64	3,354.18	6,194.25	5,471.05

（二）存货大幅增加的原因及合理性

公司2025年末存货账面余额为23,897.07万元，较上期账面余额16,947.44万元增加6,949.64万元，剔除无锡众享本期纳入合并范围导致存货账面余额增加1,373.88万元影响，公司存货账面余额仍较上期增加5,575.75万元。从2025年库龄情况来看，公司存货主要形成于2025年、2024年，合计库存占比74%。2年以上的库存主要集中于SiC系列和部分平面MOSFET产品。

从主要库存细分类别看，公司库存主要集中在平面MOSFET、电源管理IC、SiC MOSFET、FR MOSFET、功率驱动IC等，前述产品系列合计占库存余额70%。下游市场变动情况详见“一、关于经营业绩之一、（三）公司销售政策等是否发生变化，是否与下游主要客户需求产品及经营状况相匹配”中的情况说明。

从期后结转情况来看，截至2026年一季度已结转存货5,471.05万元，占库存总体比重为22.89%，占一年以内存货比重达38%，考虑春节假期影响，公司存货周转情况良好。

（二）公司经营及备货策略

公司按照客户的订单或者计划执行滚动备货，周期原则上提前3个月，但随着上游产能的调整，不排除需要提前半年甚至全年需求的备货，会出现产品集中产出。另一方面2025年公司新产品线布局整合，衍生出很多新品，为了保障客户验证后供货能力，部分产品也必须做战略性的提前储备。此外，高可靠性领域由于行业的特殊性，大部分客户没有固定计划或者需求，但对于货期要求又十分严格，虽然数量少，但涉及产品多，要求保供时间长，因此公司需要进行一定的备货。

（三）存货周转情况趋好

项目	库存周转率			经营模式
	2025年	2024年	2023年	
成都华微（688709）	0.63	0.33	0.32	Fabless模式
臻镭科技（688270）	0.52	0.69	0.88	Fabless模式
振芯科技（688193）	0.84	0.51	0.84	Fabless模式

随着公司销售业务逐步增加，公司存货周转情况向好，从近三年的存货周转率数据来看，公司2025年的周转率较2024年有了较大提升，针对目前市场同类型涉及高可靠领域的企业，从周转率变化和周转率数据上看，都属于正常范围。

（四）结合各类产品产销情况，说明在库存量较大情况下，仍大幅提高产量的原因及合理性

公司通常向晶圆厂采购定制晶圆，晶圆采购后进行销售或者进一步加工，2025年公司晶圆采购主要为FR MOSFET、沟槽MOSFET、平面MOSFET等，根据晶圆生产入库情况来看：

单位：片

产品系列	晶圆采购	晶圆采购量占比（%）	销售出库	继续进一步加工领用	新增晶圆结存
FR MOSFET	103,640	52.39	65,688	18,953	18,999
沟槽MOSFET	23,899	12.08	11,010	6,677	6,212
平面MOSFET	58,047	29.34	36,867	29,888	-
电源管理IC	1,969	1.00	111	1,730	128
功率驱动IC	2,970	1.50	1	1,254	1,715

进一步加工生产入库情况来看：

单位：万只

产品系列	进一步加工入库数量	销售出库	新增封装成品结存
FR MOSFET	881.96	1,019.06	-
沟槽MOSFET	4,524.75	3,032.54	1,492.21
平面MOSFET	3,934.60	4,193.50	-
电源管理IC	581.67	565.43	16.24
功率驱动IC	884.57	724.96	159.61

（1）FR MOSFET系列为公司2025年销售增量较大的产品类别，2025年实现销售4,170.78万元，较2024年2,060.18万元增加了102.45%，主要客户包括主要客户晶芝半导体、博创等，应用于白电智能空调、冰箱、洗衣机等家电领域，公司为了保障供货和拓展市场增加了晶圆产量。

（2）沟槽MOSFET系列完成新项目开发40余个及130余个衍生产品的小批量及中批量备货，广泛应用于中小功率电动工具、无人机、机器人的电机驱动以及BMS系统、高可靠领域等。

（3）平面MOSFET系列的增长系超高压MOSFET前期市场的推广，工控领域、智能家居、新能源汽车等领域需求上涨，带来了公司高压系列产品的加速增长，加大了该系列的晶圆备货及成品备货，目前仍在持续投入满足客户增长的需求；另外配合光继电器的MOSFET需求也有大幅提升。

（4）电源管理IC及功率驱动IC系列产品在原有高可靠领域固定产出的基础上，25年加大了消费类及工控类应用领域的推广的力度，取得了突破，针对新增的意向需求和未来的市场规划，进行了相应的IC产品备货。

整体产量增加是基于合理的产品规划及市场端的需求来进行，符合公司业务的整体规划。

二、结合存货跌价准备的计提政策、计算过程，说明存货跌价准备增幅较大的原因及合理性，库存商品、原材料计提大额减值的原因，存货跌价准备计提政策是否与前期一致；

本年度公司存货跌价准备计提相关政策与前期一致，具体如下：

1、公司存货跌价计提的可变现净值确认依据

可变现净值的确认时，公司考虑了前述相关因素，结合产品的预计销售额情况扣除存货成本、继续加工成本、相关税费等。在考虑预计销售额时，公司以资产负债表日前后产品售价为主，同时结合外部竞品价格、市场价格等确定相关产品的预计销售价格。

2、存货跌价计提的计算过程及依据情况

公司根据一贯的存货减值计提政策，对于2年以上的存货，公司基于谨慎性原则认为该部分预期无法实现对外销售，并全额计提存货跌价准备。

对于2年以内的存货部分，在存货跌价准备具体计算时，根据上述确认的产品预计销售价格计算可实现的产品销售额，扣除至销售实现仍要发生的费用、税费，计算产品的可变现净值；对于委托加工物资、外延片，以拟加工的产成品预计销售价格测算预计销售额，扣除根据近期委外加工费结算情况和除其继续加工成本、扣除至销售实现仍要发生的费用、税费计算可变现净值。对于存货余额大于可变现净值的部分计提存货减值准备。其中继续加工成本、费用率、税费率均根据本期实际发生情况予以确定。

3、近两年存货跌价准备计提情况

（1）近两年存货结存及存货跌价准备构成

单位：万元

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	跌价准备计提率	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	跌价准备计提率
原材料	1,186.90	805.14	381.76	67.84%	511.56	45.74	465.82	8.94%
在产品	19.27	-	19.27	0.00%	-	-	-	-
委托加工物资	4,691.03	389.16	4,301.87	8.30%	2,007.35	271.29	1,735.95	13.52%
库存商品	17,110.57	7,691.26	9,419.31	44.95%	13,650.36	4,941.03	8,709.33	36.20%
发出商品	109.04	12.40	96.64	11.38%	99.26	1.89	97.37	1.91%
合同履约成本	780.26	276.72	503.54	35.46%	678.90	254.89	424.01	37.55%
合计	23,897.07	9,174.69	14,722.38	38.39%	16,947.44	5,514.95	11,432.48	32.54%

公司2025年末存货跌价准备9,174.69万元，较2024年存货跌价准备5,514.95万元增加3,659.74万元。

（2）存货跌价准备增加的原因

公司存货跌价准备增加主要受存货库龄增加以及市场竞争产品价格下降双重原因导致的。库龄方面，公司2025年末2年以上存货余额5,909.16万元，较年初2,806.45万元，增加了3,102.71万元，根据公司的存货跌价计提政策，对两年以上存货全额计提减值准备，使得存货跌价准备计提增加了3,102.71万元。产品价格方面，近两年受市场竞争等因素影响，部分产品价格下降使得产品减值风险增加，2025年末根据预计售价测算需计提存货跌价准备3,265.53万元，2025年初该部分计提金额为2,708.50万元，较年初增加了557.03万元。前述因素合计使得存货跌价准备余额较年初增加了3,659.74万元。

三、对于库龄2年以上的存货，说明具体的存货类型、对应产品、形成时间、生产背景、是否有对应订单、长期未结转原因、历史产销量变动情况。

库龄2年以上的存货具体情况如下：

单位：万元

项目	产品大类	明细分类	2年以上库存金额	库存形成时间		
				2023年度	2022年度	2021年及以前年度
原材料	功率器件	SiC MOSFET	736.00	734.10	1.90	0.00
		平面MOSFET	33.66	14.40	1.23	18.03
		其他	0.46	0.46	-	-
	功率IC	电源管理IC	8.16	8.16	-	-
	小计		778.27	757.11	3.13	18.03
库存商品	功率器件	平面MOSFET	1,338.35	720.93	566.81	50.62
		SiC MOSFET	1,269.40	645.75	597.67	25.98
		超结MOSFET	721.86	674.51	32.20	15.15
		FR MOSFET	265.49	23.58	227.98	13.94
		沟槽MOSFET	209.77	42.88	145.22	21.66
		其他	206.33	72.39	124.16	9.78
		屏蔽栅MOSFET	115.73	36.46	64.86	14.41
	功率IC	电源管理IC	348.95	199.80	96.72	52.43
		功率驱动IC	341.20	222.00	97.05	22.16
		隔离固态继电器	196.73	147.53	22.61	26.60
		其他	114.98	114.77	0.21	-
	小计		5,128.80	2,900.59	1,975.48	252.73

由上表可见，2年以上库存主要系2022年至2023年度期间形成，相关库存商品历史产销情况如下：

单位：万元

产品大类	明细分类	2023年度		2022年度	
		采购金额	销售结转金额	采购金额	销售结转金额
功率器件	平面MOSFET	8,807.66	6,182.07	16,230.63	9,244.01
	SiC MOSFET	2,413.88	216.42	1,299.77	184.97
	超结MOSFET	2,015.07	764.21	484.19	413.73
	FR MOSFET	1,654.15	1,850.03	1,372.99	541.67
	沟槽MOSFET	252.96	168.21	284.55	88.23
	其他	216.19	240.02	262.53	114.32
	屏蔽栅MOSFET	114.03	828.42	236.28	326.67
功率IC	电源管理IC	1,333.91	294.61	1,547.33	878.29
	功率驱动IC	553.46	42.01	405.59	31.22
	隔离固态继电器	1,578.57	356.56	252.85	61.36
	其他	144.25	41.94	99.23	67.30
小计		19,084.13	10,984.51	22,475.95	11,951.77

功率器件方面，近年来，由于全球代工厂和整机厂商面临销售周期放缓，下游品牌商对订单的可预期性降低，导致采购步伐大幅放缓。终端需求的疲软，推高了通用型MOSFET的库存水位。与此同时，市场需求正在向新能源汽车、工业电源、光伏储能等领域转移，这些领域更青睐高压、大电流的高端功率器件。

目前整个半导体行业面临着“高端缺货、低端过剩”的局面。一方面，由于新能源汽车、AI服务器等高景气度赛道的爆发，导致主流、高压型号的大功率MOS管